

-DATA SHEET---

WAVE SOLDER TROUBLESHOOTING GUIDE

CAUSE	လွ	So	So	တွ	So	So	Ш	P	Pr	Flux	Flux	Flux	Flux	Flux	Flux	Ę	Ţ	N	Pa	ဂ္ဂ	δ	ပ္ပ	ဂ္ဂ	ဂ္ဂ	Ę	ВС
	Solder te	Solder te	Solder wa	Solder wa	Solder wa	Solder contaminated	Excessive	Preheat temp.	Preheat t	x cont	ıx specific	x specific	on xr	x not	ux foar	Fluxer uneven	Flux blow-off excessive	No flux blow-off	Pallet too hot	Conveyor speed	Conveyor	Conveyor	Conveyor angle high	Conveyor angle	Early removal	Board not seated right
*	temp. high	temp. low	wave he	wave he	wave un	ontami			temp.	contaminated	cific gr	cific gr	no longer	not making	foamhead low	neven	v-off e	low-of	hot	spee	speed low	r vibration	r angle	r angle	noval c	t seat
· ·	y h	٧	height h	height lo	uneven	nated	solder dross	high	low	ted	gravity I	gravity h	active	g contact	low		xcess			d high	d low	iön	high	low	of board	ed rigi
SYMPTOM			high	low			SS				low	high		act			ve								a	#
Insufficient solder flow thru	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•			•
Insufficient solder (solder side)	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•			•
De-wetting or non-wetting		•		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•
Solder voids or outgassing	•	•		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•			•
Excessive solder (solder side)		•			•	•					•	•	•			•		•	•	•	•			•		•
Icicles		•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•		•		•	•	•
Bridging		•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•			•		
Webbing		•				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•					
Solder balls and splatter	•		•		•				•	•	•							•		•		L				
Rough or disturbed solder		•		•	•	•	•													•		•			•	•
Grainy solder		•				•	•		•											•		•			•	
Cold solder joint	•	•				•			•											•	•	•			•	
Discoloured solder joint	•					•		•	•	•										•	•					L
Flux entrapment									•	•		•						•		•						
Blistering	•							•													•					
Measling	•							•													•					
Components lifted			•		•												•					•	•		•	•
Warpage	•							•	•												•					•